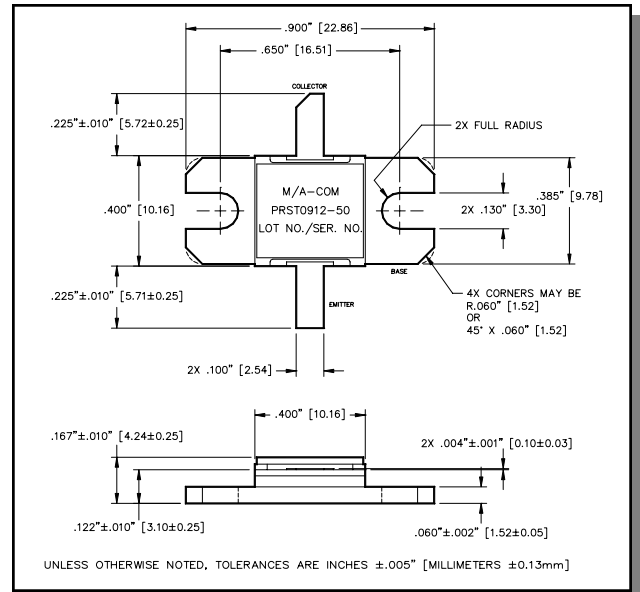


Features

- NPN silicon microwave power transistors
- Common base configuration
- Broadband Class C operation
- High efficiency inter-digitized geometry
- Diffused emitter ballasting resistors
- Gold metallization system
- Internal input and output impedance matching
- Hermetic metal/ceramic package
- RoHS Compliant

Outline Drawing



Absolute Maximum Ratings at 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	65	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	3.0	V
Collector Current (Peak)	I_C	5.3	A
Power Dissipation @ +25°C	P_{TOT}	220	kW
Storage Temperature	T_{STG}	-65 to +200	°C
Junction Temperature	T_J	200	°C

Electrical Specifications: $T_C = 25 \pm 5^\circ\text{C}$ (Room Ambient)

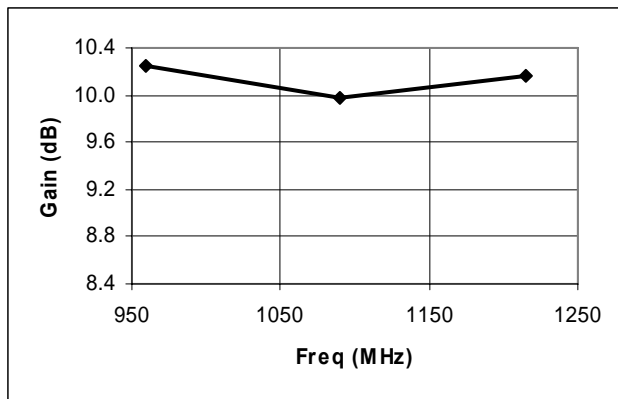
Parameter	Test Conditions	Frequency	Symbol	Min	Max	Units
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 15\text{mA}$		BV_{CES}	65	-	V
Collector-Emitter Leakage Current	$V_{CE} = 40\text{V}$		I_{CES}	-	2.0	mA
Thermal Resistance	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	$R_{TH(JC)}$	-	0.80	°C/W
Output Power	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	P_O	50	-	W
Power Gain	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	G_P	9.1	-	dB
Collector Efficiency	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	η_C	40	-	%
Input Return Loss	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	RL	-	-9	dB
Load Mismatch Stability	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960 MHz	VSWR-T	-	10:1	-
Load Mismatch Tolerance	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	VSWR-S	-	1.5:1	-

Typical RF Performance

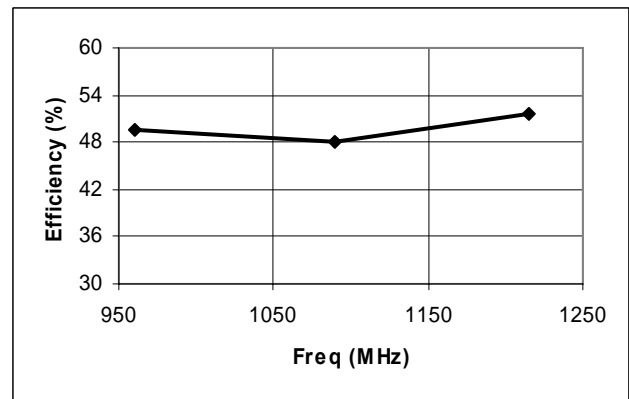
Freq. (MHz)	Pin (W)	Pout (W)	Gain (dB)	ΔGain (dB)	Ic (A)	Eff (%)	RL (dB)	VSWR-S (1.5:1)	VSWR-T (10:1)	P1dB Overdrive	
										Pout	Δ Po
960	6.2	65.9	10.25	-	2.66	49.6	-22.2	S	P	73.4	0.48
1090	6.2	61.9	9.98	-	2.58	48.0	-15.2	S	-	68.7	0.45
1215	6.2	64.6	10.16	0.35	2.50	51.6	-15.9	S	-	74.8	0.63

Note: ΔPo(dB) is the difference between Pout at 1dB overdrive and Pout at Pin = 6.2W.

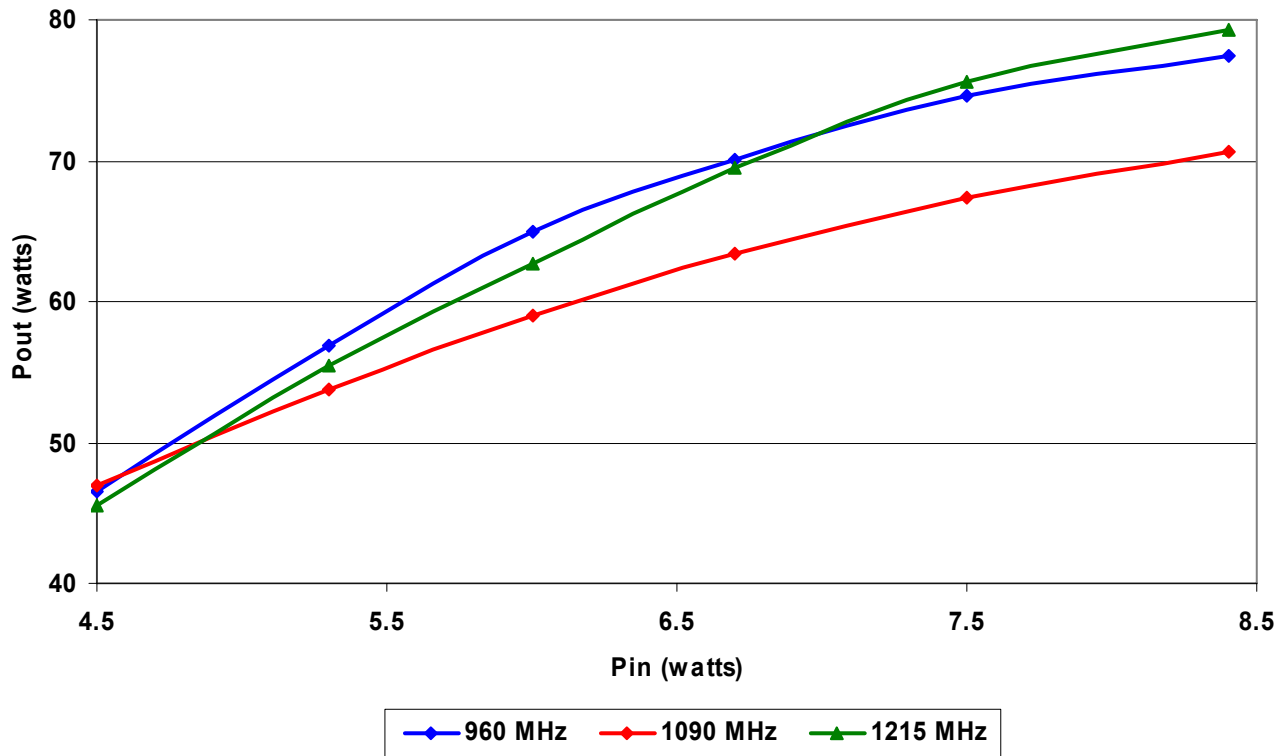
Gain vs. Frequency



Collector Efficiency vs. Frequency

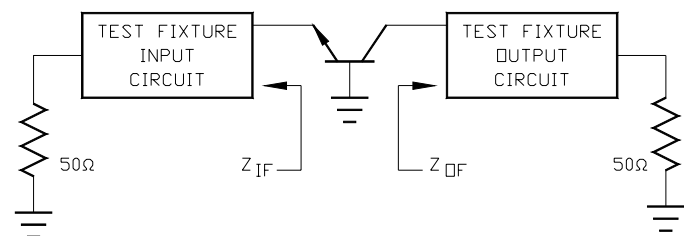


RF Power Transfer Curve (Output Power Vs. Input Power)

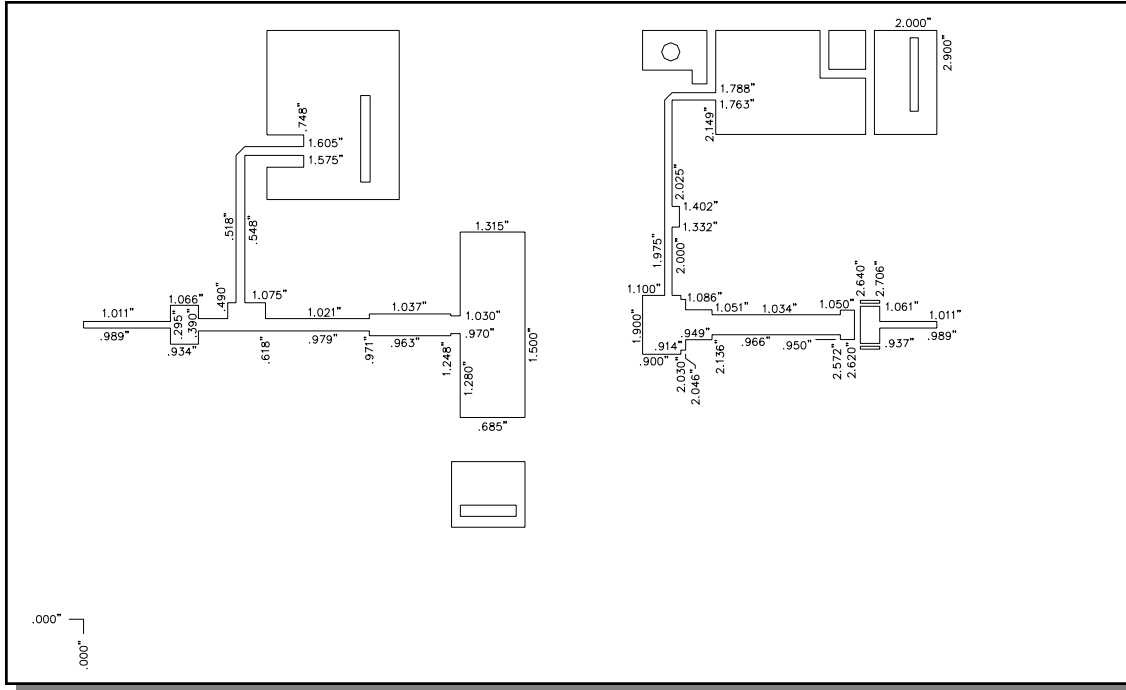


Broadband Test Fixture Impedance

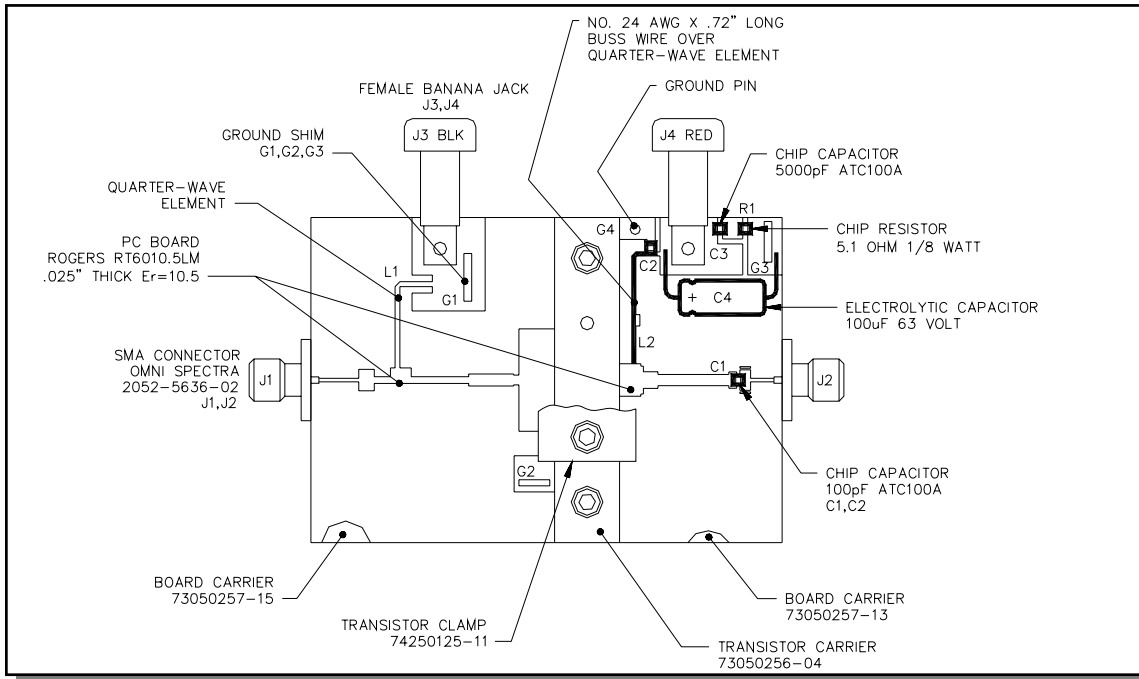
F (MHz)	Z _{IF} (Ω)	Z _{OF} (Ω)
960	3.5 - j7.5	12.0 - j7.8
1030	3.8 - j7.0	11.1 - j6.4
1090	3.9 - j6.8	10.6 - j5.1
1150	3.9 - j6.8	10.8 - j3.8
1215	3.6 - j7.0	11.1 - j3.2



Test Fixture Circuit Dimensions



Test Fixture Assembly



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9